



Lichtblicke

Deutsches Eigenkapitalforum

23. – 24. November 2010

Dr. Ingo Bretthauer (CEO), Kai Bentz (CFO)



- Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau
- steigende Auftragseingänge in allen Segmenten
- Prognose für 2010: Umsatz ca. € 79 Mio., EBIT-Marge ca. 19 %

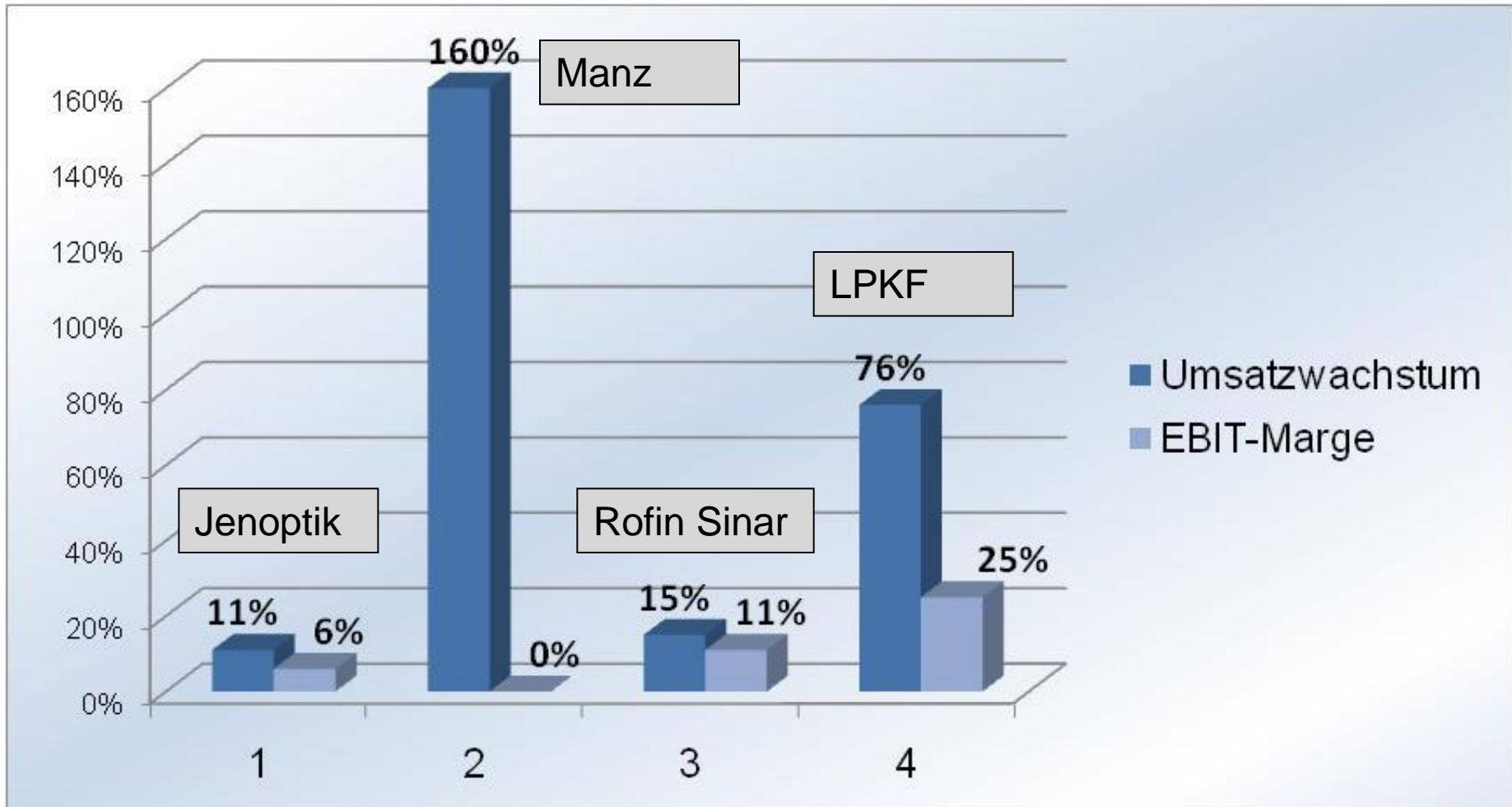
Konzernkennzahlen Q3 2010

	9 Monate 2010	9 Monate 2009	Veränderung (%)	Jahr 2009
Umsatz (Mio. €)	60,9	34,7	75,6	50,7
EBIT (Mio. €)	14,9	5,0	201,0	7,0
EBIT-Marge (%)	24,5	14,3		13,7
Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter (Mio. €)	10,3	3,2	225,1	4,7
Net Working Capital (Mio. €)	28,4	20,3	39,8	20,4
ROCE (%)	28,2	11,2		15,7
EPS, verwässert (€)	0,94	0,29	224,1	0,43
Finanzmittelbestand (Mio. €)	11,8	9,2	28,1	10,3
Eigenkapitalquote (%)	67,2	68,6		69,7
Auftragsbestand (Mio. €)	18,2	19,8	-7,7	14,7
Auftragseingang (Mio. €)	64,4	44,1	45,9	56,0

Segmente

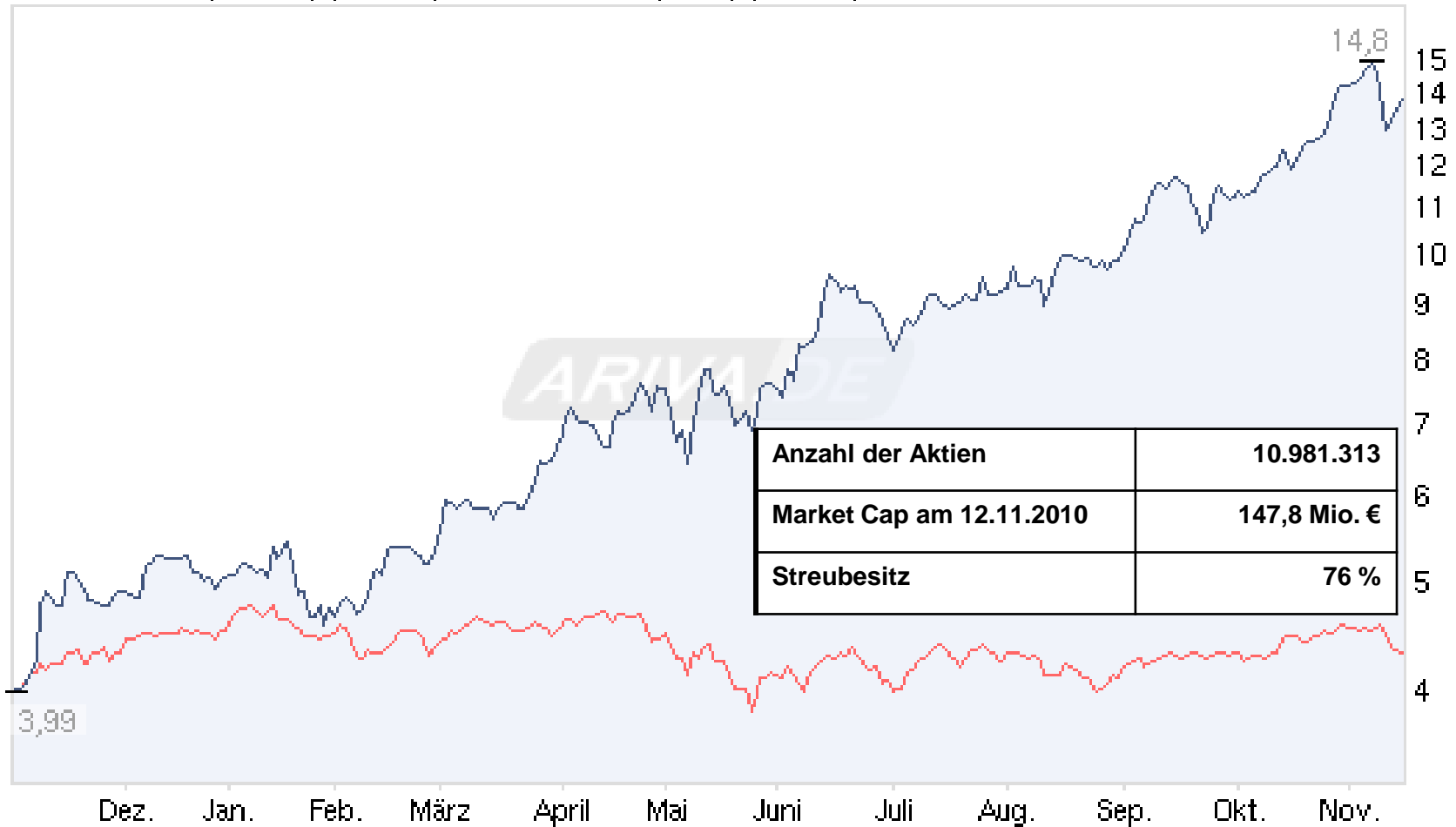
in Mio. €	Umsatz		EBIT	
	9 Monate 2010	9 Monate 2009	9 Monate 2010	9 Monate 2009
Schneid- und Strukturierungslaser	42,6	17,0	15,2	4,2
Rapid Prototyping	10,3	9,1	2,1	1,3
Fügetechnologien	5,1	3,8	0,1	0,2
Dünnschicht- technologien	0,7	3,4	-1,4	-0,1
Alle sonstigen Segmente	2,2	1,4	-1,1	-0,6
Summe	60,9	34,7	14,9	5,0

Peer Group-Vergleich: 9 Monate 2010



Die LPKF-Aktie in 2010

■ LPKF Laser (XETRA) (in EUR) ■ TecDAX (Perf.) (in EUR)



Pionier mit Bodenhaftung

Branche: Die Lasertechnik ist eine Schlüsseltechnologie, die seit 50 Jahren Wissenschaft und Industrie revolutioniert. Ihr immenses Zukunftspotenzial ist unbestritten.

Marktposition: LPKF ist Pionier bei der Erschließung neuer Märkte für den Einsatz der Lasertechnologie in der Mikromaterialbearbeitung und hat sich in vielen Bereichen eine weltweit führende Position erobert.

Kompetenz: Spezielles Know-how und Erfahrung rund um die Materialbearbeitung mit dem Laser sind die Basis für alle Segmente des LPKF-Konzerns.

Pionier mit Bodenhaftung

Strategie: Das breit gefächerte Portfolio bildet ein stabiles Fundament. Ein globales Vertriebs- und Servicenetz sichert die Nähe zum Kunden. Fast alle Bereiche zielen auf die Ablösung etablierter Technologien in der Produktion.

Wachstumschancen: LPKF hat sich zum Ziel gesetzt, die Lasertechnologie von dem Image einer teuren Elite-Technologie zu befreien und in eine wirtschaftliche Produktionstechnik zu verwandeln.

Track Record: Seit über 30 Jahren hat LPKF profitabel gewirtschaftet und eine überdurchschnittlich solide Vermögensstruktur bewahrt.

Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser

Lasertechnik &
Optik

Präzisions-
antriebs-
technik

Steuerungs-
technik &
Software

Märkte, Segmente, Produktlinien

Märkte

Elektronik

Kunststoffe

Photovoltaik

Segmente

Rapid Prototyping

Schneid- und Strukturierungslaser

Füge-technologien

Dünnschicht-technologien

Produktlinien

Proto-Maten

Proto-Laser

Zubehör

Stencil-Laser

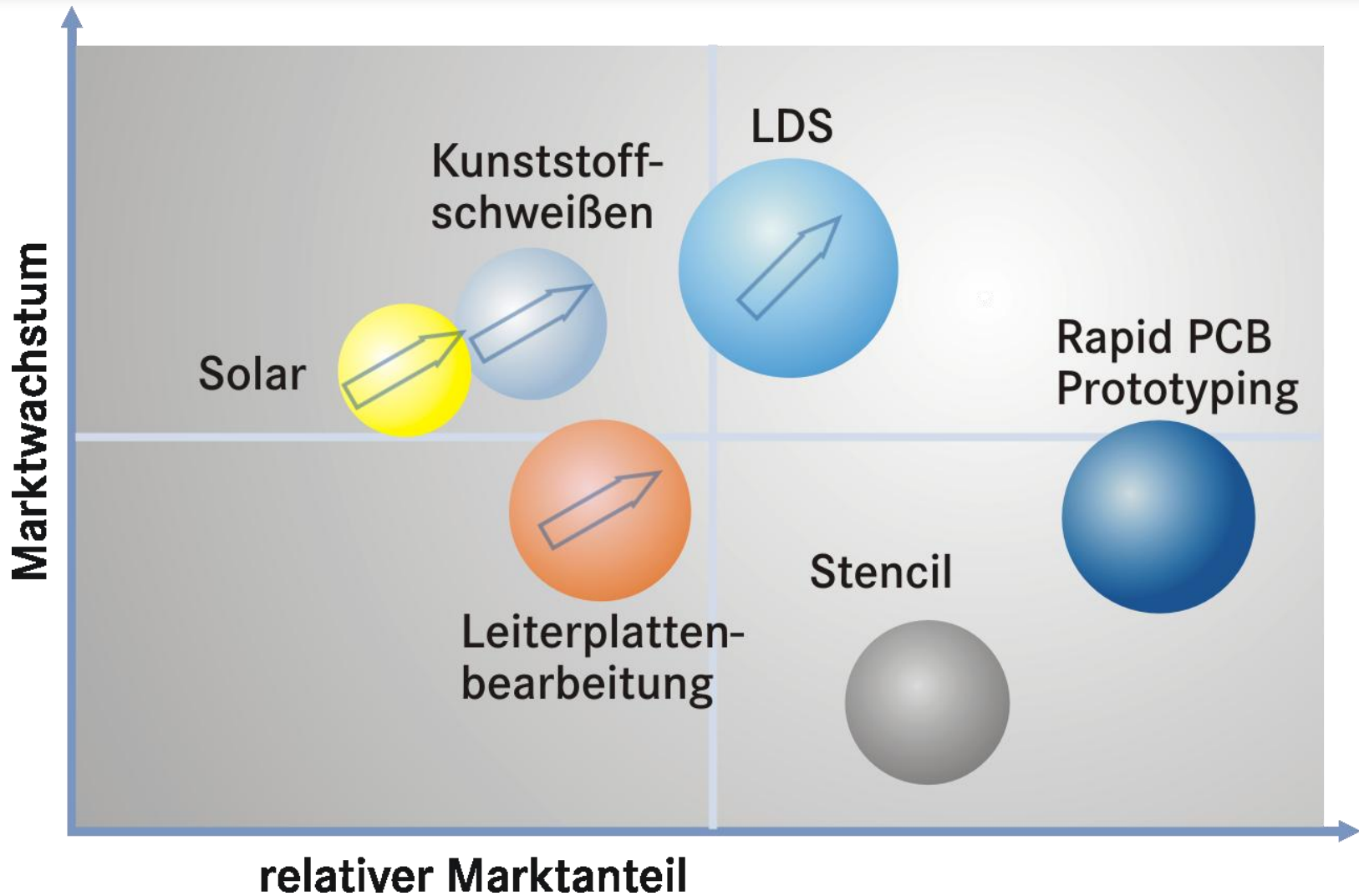
PCB Schneid-laser

Laser-Direkt-Strukturierung (LDS)

Laser-Kunststoffschweißen

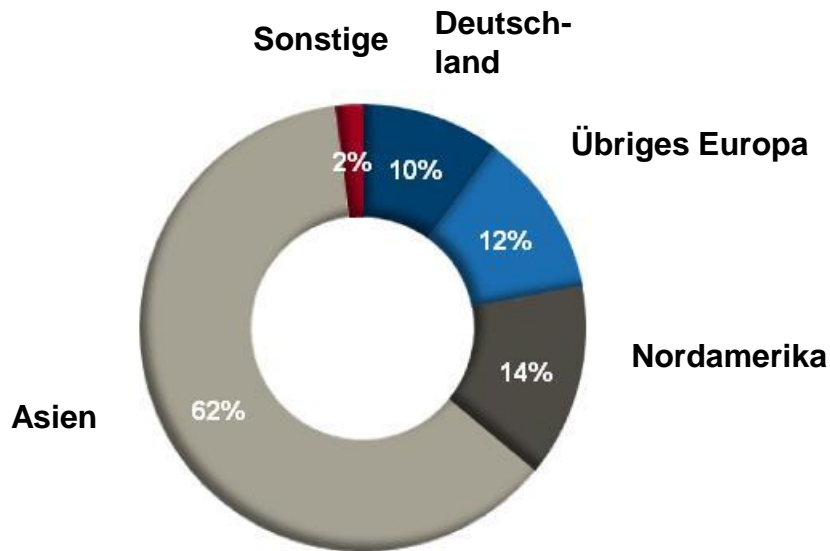
Laser-Scriber

Portfolio

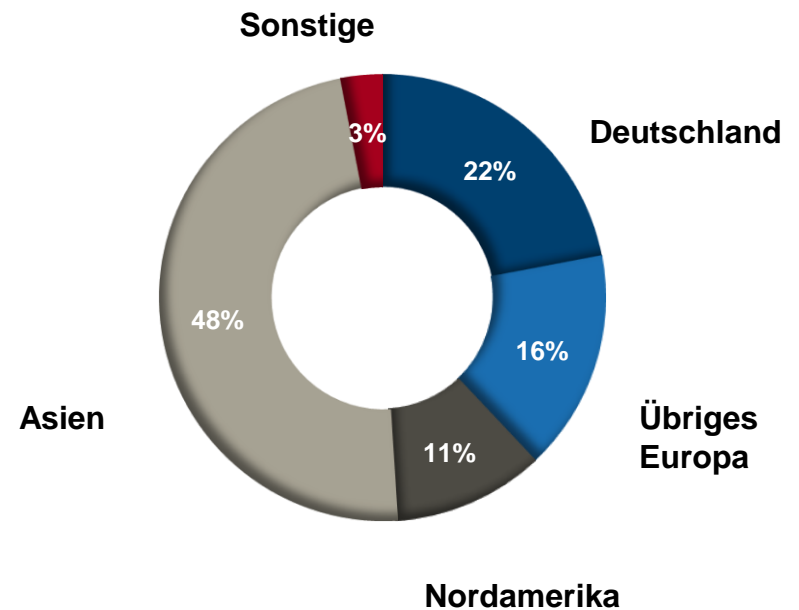


90 % Exportanteil

9 Monate 2010: € 60,9 Mio.



9 Monate 2009: € 34,7 Mio.



Segment Rapid Prototyping

Ausrüstung zur Herstellung von Leiterplatten-Prototypen

Kunden: Universitäten, Schulen, Industrie

Marktposition: ca. 70 % Marktanteil

Wettbewerb: MITS (J)
Everprecision (TW)
T-Tech (USA) u. a.

strategisches Ziel: Ausbau der Marktführerschaft



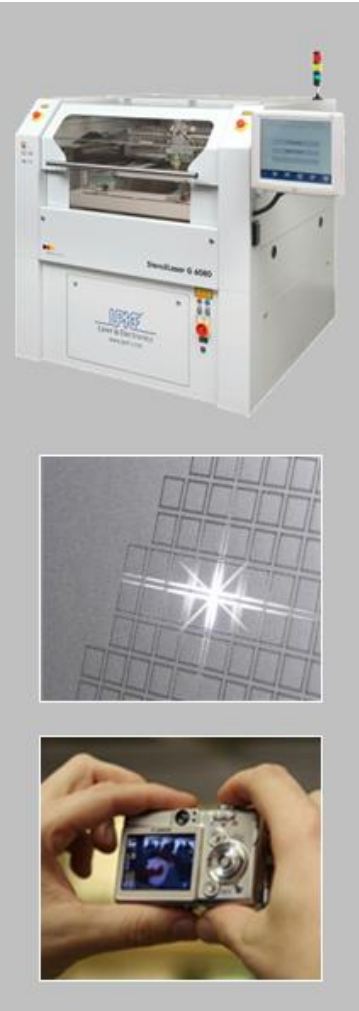
Schneidlaser zur Herstellung von SMT Siebdruckschablonen (Stencils)

Kunden: Elektronikindustrie
Hersteller von SMT-Schablonen

Marktposition: ca. 70 % Marktanteil

Wettbewerb: TechSource (USA) und andere kleine
Anbieter

strategisches Ziel: Ausbau der Marktführerschaft
Erschließung neuer Kundengruppen



Strukturierungslaser zur Herstellung von dreidimensionalen Schaltungsträgern mit dem von LPKF patentierten LDS-Verfahren

Kunden:

Hersteller von elektronischen Baugruppen und Geräten

Marktposition:

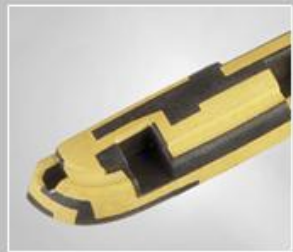
Marktführer bei MID-Antennen

Wettbewerb:

alternative Verfahren

strategisches Ziel:

LPKF-LDS als Standardprozess für die Herstellung bestimmter MID-Typen

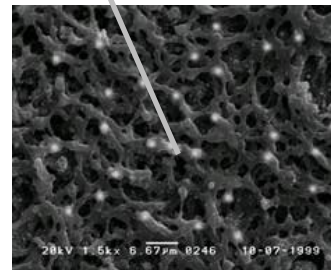
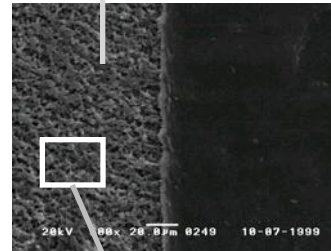


Das LDS-Verfahren

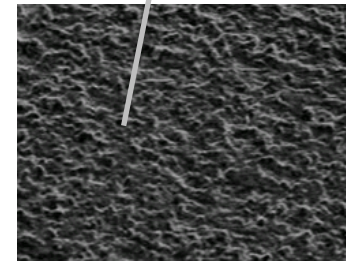
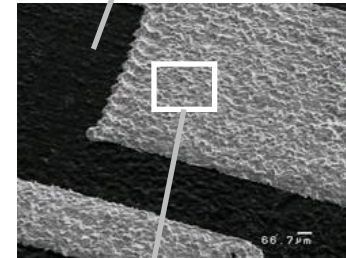
1. Spritzguss



2. Laserstrukturierung



3. Metallisierung



In drei Schritten vom spritzgegossenen Plastikgehäuse zum dreidimensionalen Schaltungsträger

Weitere LDS-Anwendungen

- Computer
- Automotive
- Medizintechnik
- Sicherheitstechnik
- ...



Lasersysteme zum Ausschneiden von bestückten und unbestückten Leiterplatten

Kunden:

Leiterplattenhersteller
Leiterplattenbestücker

Marktposition:

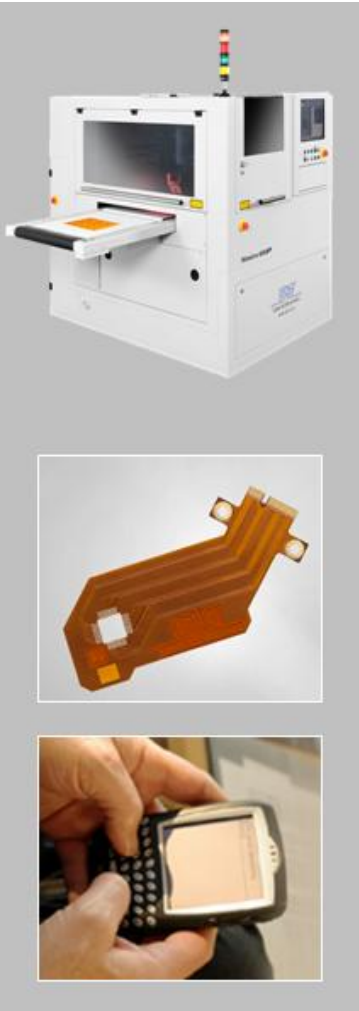
kleiner Anbieter

Wettbewerb:

HAN'S (China), ESI (USA) und andere
kleine Anbieter

strategisches Ziel:

Vorzugslieferant führender
Elektronikhersteller



Schweißen von Kunststoffteilen mit dem Laser

Kunden:

Automotive
Medizintechnik

Marktposition:

Top 3

Wettbewerb:

Leister (CH)
Bielomatik (D)
Branson (USA)

strategisches Ziel:

Vorzugslieferant
internationaler Unternehmen
Marktführer



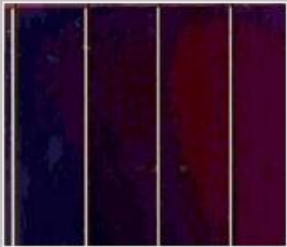
Strukturieren von Dünnschichtsolarzellen

Kunden: Dünnschicht-Solarzellenhersteller

Marktposition: kleinerer Marktteilnehmer

Wettbewerb: Manz (D)
Oerlikon (CH)
Innolas (D)

strategisches Ziel: Vorstoß in Top 2 Marktposition



	30.09.2010	31.12.2009
Mitarbeiter weltweit	453	384
Krankenstand	3,3 % am Standort Garbsen (< Durchschnitt in Metall- und Elektronikindustrie)	
Fluktuation	sehr gering	

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. €)

	9 Monate 2010	9 Monate 2009
Umsatzerlöse	60,9	34,7
Bestandsveränderungen	0,3	-0,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	2,2	2,0
Sonstige Erträge	1,4	0,8
Materialaufwand	15,4	9,8
Personalaufwand	17,1	12,8
Abschreibungen	3,0	2,1
Sonstige Aufwendungen	14,4	7,7
EBIT	14,9	5,0
Finanzergebnis	-0,1	-0,2
Ertragsteuern	4,2	1,5
Konzernjahresüberschuss	10,6	3,3
Minderheitenanteile	0,3	0,1
Konzernergebnis	10,3	3,2

Cashflow-Rechnung (in Mio. €)

	9 Monate 2010	9 Monate 2009
Zufluss aus laufender Tätigkeit	10,7	7,5
Abfluss aus Investitionstätigkeit	6,7	2,7
Abfluss aus Finanzierungstätigkeit	2,5	1,4
Veränderung Finanzmittelbestand	1,5	3,2
Finanzmittelbestand am 01.01.	10,3	6,0
Finanzmittelbestand am 30.09.	11,8	9,2

Vertrieb

LDS-Applikationsbasis erweitern,
Marketing, Vertrieb und Service in Asien weiter ausbauen,
Vertrieb der ProtoLaser-Familie weltweit forcieren

Entwicklung

LDS: 2. Generation „Fusion“
RP: komplette Erneuerung des ProtoMaten-Programms
Dünnschichtstrukturierer: 2. Generation „Allegro“
Speziell angepasste Laserquellen

Organisation Konzernwachstum organisatorisch unterstützen und sichern,
Einführung einer integrierten Unternehmenssoftware (ERP)

Investitionen Erweiterung Produktionskapazität Garbsen,
Entwicklungsprojekte,
Demosysteme



Anhang

Konzernbilanz (in Mio. €)

Aktiva	30.09.2010	31.12.2009
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	5,2	5,1
Sachanlagen	15,3	13,4
Sonstige langfristige Vermögenswerte	3,7	1,1
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	20,6	14,5
Forderungen u. sonst. Vermögenswerte	16,7	10,8
Liquide Mittel	12,2	12,7
Summe	73,7	57,6

Konzernbilanz (in Mio. €)

Passiva	30.09.2010	31.12.2009
Eigenkapital Eigenkapitalquote 67 % (Vj: 70 %)	49,5	40,2
Langfristige Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten	2,4	2,8
Andere Verbindlichkeiten	1,8	1,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten	0,8	1,3
Andere Verbindlichkeiten	19,2	11,4
Summe	73,7	57,6



30. März 2011	Geschäftsbericht 2010
31. März 2011	Analystenkonferenz
13. Mai 2011	3-Monatsbericht 2011
1. Juni 2011	Hauptversammlung
12. August 2011	6-Monatsbericht 2011
11. November 2011	9-Monatsbericht 2011

- **Haftungsausschluss**

- **Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen**

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Aussagen zu zukünftigen Erwartungen welche die gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse wiedergeben. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten, die nicht von der LPKF Laser & Electronics AG kontrolliert oder genau abgeschätzt werden können und die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen.

- Tatsächliche Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse können aus folgenden Gründen unbeschränkt abweichen: (i) allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, (ii) zukünftige Wertentwicklung der Finanzmärkte, (iii) Zinsraten, (iv) Wechselkurse, (v) das Verhalten anderer Marktteilnehmer, (vi) allgemeine Wettbewerbsfaktoren, (vii) Gesetzes- und Richtlinienänderungen, (viii) Politikwechsel der Zentralbanken, Regierungsbehörden und/oder (ausländischer) Regierungen, (ix) regionale und/oder globale Grundlagen.

- LPKF übernimmt keinerlei Gewährleistung und beabsichtigt keine Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen um Ereignisse oder Umstände nach Veröffentlichung dieser Materialien widerzuspiegeln.

- **Ausschluss der Aktualisierung**

LPKF AG übernimmt keine Gewähr für die (Richtigkeit und Vollständigkeit der) enthaltenen Informationen und beabsichtigt nicht, sie zu aktualisieren.

- **Angebotsausschluss**

Diese Präsentation dient lediglich zur Information und stellt keine Investitionsempfehlung dar. Es handelt sich nicht um ein Angebot sondern dient der allgemeinen Information. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Beschreibungen, Beispiele und Berechnungen dienen nur zur Veranschaulichung.

- **Eingetragene Warenzeichen**

Alle in diesem Dokument enthaltenen Namen und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweils geltenden Urheberrechten und dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung der jeweiligen eingetragenen Inhaber genutzt werden. Die Tatsache, dass sie in diesem Dokument erwähnt werden bedeutet nicht, dass sie nicht durch Rechte dritter Personen oder Unternehmen geschützt sind.

- **LPKF Laser & Electronics AG, 2010**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

LPKF Laser & Electronics AG · Osteriede 7 · 30827 Garbsen · www.lpkf.de

Kontakt: Bettina Schäfer, Investor Relations,

Tel: 05131-70 95 382, b.schaefer@lpkf.de

